

<<印制电路用覆铜箔层压板>>

图书基本信息

书名：<<印制电路用覆铜箔层压板>>

13位ISBN编号：9787502536688

10位ISBN编号：750253668X

出版时间：2002-6

出版时间：化学工业出版社

作者：辜信实编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<印制电路用覆铜箔层压板>>

内容概要

覆铜箔层压板是电子工业的基础材料，主要用于制造印制电路板，广泛用于彩色电视机、计算机、通讯设备等。

本书系统介绍覆铜板的分类，主要原材料，生产技术，产品标准，检验方法，三废治理，产品应用加工，技术发展等。

<<印制电路用覆铜箔层压板>>

书籍目录

- 第一章 绪论
- 第二章 覆铜板的标准
- 第三章 覆铜板用主要设备与工装
- 第四章 覆铜板的生产环境
- 第五章 覆铜板用主要原材料
- 第六章 纸基覆铜板
- 第七章 环氧玻纤布覆铜板
- 第八章 复合基覆铜板
- 第九章 各种高性能覆铜板
- 第十章 积层多层板用涂树脂铜箔
- 第十一章 金属基覆铜板
- 第十二章 陶瓷基覆铜板
- 第十三章 挠性覆铜板
- 第十四章 覆铜板检测技术
- 第十五章 环境保护与三废治理
- 第十六章 覆铜板加工与应用的基本知识
- 第十七章 覆铜板技术发展的趋势
- 附录 常见非法定计量单位和换算系数

<<印制电路用覆铜箔层压板>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>